

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	嘉合基金、诺安基金、长江养老、信达澳亚、华泰资产、华商基金、银河基金、银华基金、广发基金、前海开源、中泰证券、财通证券、中信保诚基金、国联证券、易方达、国盛证券、宁泉资产、睿郡资产、国信证券、博时基金、中欧基金、华夏久盈、华泰柏瑞、百年保险资管、民生证券、中邮证券、中信建投、长江证券、摩根基金、兴证全球、南方基金、德邦证券、华泰证券、嘉实基金、国投瑞银、农银汇理共 36 家机构。
时间	2024 年 4 月 24 日-2024 年 5 月 31 日
地点	公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概述 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据

分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、2023 年半导体行业发展放缓的情况下公司取得了较好的业绩表现，请公司对 2023 年度业务营收做简要介绍？

2023 年，全球集成电路行业总体处于“周期下行-底部复苏”阶段，国内集成电路产业也面临着国际环境、产业周期等内外部环境的挑战。公司根据行业发展趋势推出解决客户痛点的高性价比产品，持续发挥全流程良率提升的软硬件协同优势，为客户提供高附加价值的产品和方案，并进一步拓展集成电路设计类客户，公司年度业绩保持稳定增长态势。

2023 年，公司年度共计实现营业收入额为 47,761.58 万元，同比增长 34.31%，近三年复合增长率为 55.27%。在净利润方面，2023 年度实现归母净利润 12,880.32 万元，同比增长 5.30%，近三年复合增长率达到 42.15%，实现归母扣非净利润 10,994.58 万元，同比增长 7.09%，近三年复合增长率 64.55%。

2、近两年半导体行业增长放缓，EDA 领域品类多、产品链长，公司在竞争激烈的市场中如何保持可持续发展？

公司早期以 EDA 软件为起点，研发了一整套用于集成电路良率提升的测试芯片设计 EDA 软件。同时为提升流片后的测试效率，公司研发了高速晶圆级电性测试设备，通过硬件配套充分发挥 EDA 软件的技术价值、促进软件收入增长。后期，随着设备产品的技术迭代，并成为可用于芯片量产的 WAT 测试机，其单价高、放量快的特点促进公司的业绩连年快速增长。而 EDA 软件由于品类多、产品链长，且具有研发投入高、商业验证周期长的特点，虽然在集成电路产业链中的地位非常高，但是研发难度和实现盈利的难度也极其大。近两年，公司在高投入研

发 DFT、DFM、半导体大数据分析系统等软件工具的过程中，公司的测试设备硬件营收发挥着关键作用，为 EDA 软件的研发和成熟提供费用支撑，并保障公司在业务营收稳定增长的同时实现利润攀升。

经过过去几年脚踏实地的技术积累和软、硬件产品战略布局，公司逐渐形成了 EDA 软件、半导体大数据平台及电性测试设备相结合并驱动业绩可持续发展的“三驾马车”。中长期展望，公司在软件端的产品和技术布局，在经过一段时间的势能积累后，将会突破现有的成长速度并与设备产品并驾齐驱，在提升公司软硬一体化解决方案的同时，共同助力公司的业务稳定增长。

同时，公司在软硬件研发上始终以行业领先水平为目标，着眼于国际集成电路市场，2023 年度，公司为设备、软件的出海做了诸多努力和布局，包括设立新加坡子公司、投资海外合作伙伴等，后期公司将持续加强海外业务推广力度和深度，赋能公司业务的稳健、可持续发展。

3、公司 2023 年度研发费用相对往年有较大提升，请简要介绍公司本年度的研发成果？

为保障技术的先进性并巩固和提高公司技术壁垒，公司多年来始终保持高比例的研发投入，特别是 2023 年，公司的研发费用额超过 2 亿元，占营业收入的 43.38%，同比增长 67.70%；研发人员数量也从年初的 248 人增加至年末的 416 人。2023 年公司的主要研发成果包括：

第一，在 EDA 软件方向，我们研发了高效的工艺过程监控（PCM）方案，将我们成品率提升方案从工艺开发拓展到芯片量产环节；我们延伸布局可制造性 DFM 系列软件，降低芯片研发难度和制造成本；同时我们发布了领先的一站式可测试性（DFT）设计解决方案，这也标志着公司的软件产品从制造类 EDA 拓展到了设计类 EDA。

第二，在数据软件方向，我们深入挖掘集成电路数据价值，初步完成了成套的离线大数据分析系统的布局，并持续延伸布局在线大数据分析和控制系统；另一方面，我们积极拥抱技术变革，特别是人工智能技术，实现了机器学习在半导体数据分析领域的一些成功应用。

第三，在电性测试设备方面，公司推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备（T4000 型号），并横向拓展研发了半导体晶圆级可靠性测试设备，不断提升产品的技术优势与核心竞争力。

未来，公司将持续加大研发投入，积极进行前瞻性技术布局，进一步巩固技术壁垒，形成新的业绩增长点。

4、2024 年公司的主要研发项目包括哪些？

公司多年来始终以不断技术创新为企业发展根本，持续加大研发投入，保障公司产品和技术先进性的优势，积极进行前瞻性技术布局，进一步巩固技术壁垒，以实现公司长远、稳健的可持续发展。

2024 年公司将持续加大研发投入，构建更完善的 EDA 软件及电性测试设备相结合的解决方案，公司的主要研发项目包括：DFM 工具平台开发和创新技术研究、DFT 设计关键技术及应用研究、集成电路工艺量产监控方案优化、SRAM 功能模块电路设计与实现技术研发、AI 技术在半导体大数据分析中的应用与研究、电性测试效率提升方案研发等，具体可以参考公司 2023 年年度报告中的相关章节内容。

5、EDA 产业链长、产品品类多，公司 2024 年是否会有收并购的规划？

上市公司收并购是一种加快企业做大做强的重要手段，EDA 行业具有产品链长、工具品类繁多、技术门槛高等特点，纵观国际 EDA 龙头企业的发展史均是频繁的收并购史，通过收并购加快产品矩阵布局、整合提升企业的竞争力，成长壮大并

	<p>发展成为业界顶尖企业。</p> <p>公司将借鉴 EDA 产业界的成功经验，根据企业的总体战略规划，立足自身稳健发展的同时，积极关注与公司业务相关领域的发展情况，综合考虑内外部的多方面因素，合理运用资本工具加速公司成长和发展，助力公司不断提升综合实力和市场竞争能力。同时，公司也将严格遵守相关法律法规的要求，当出现上述重大事项时及时向广大投资者披露。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2024 年 6 月 4 日